
南亞電路板股份有限公司 2022年前三季營運概況

2022年11月10日



免責聲明

歷史事件的陳述可能包括未經會計師審閱之資訊，其可能有某些不足或缺陷而無法忠實呈現目前南亞電路板股份有限公司之財務狀況或營運結果。

本公司未來實際所發生的營運結果、財務狀況以及業務展望，可能與本會明示或暗示的預估有所差異。其原因可能來自於各種因素，包括但不限於市場需求、價格波動、競爭情勢、國際經濟狀況、供應鏈、匯率波動以及其他本公司所不能掌控的風險等因素。

除主管機關要求公開之資訊外，本公司並無義務揭露或更新對未來產品方面之意見與看法。



議程

- 公司概況
- 財務狀況
- 產品未來發展方向
- 未來營運目標



公司概況

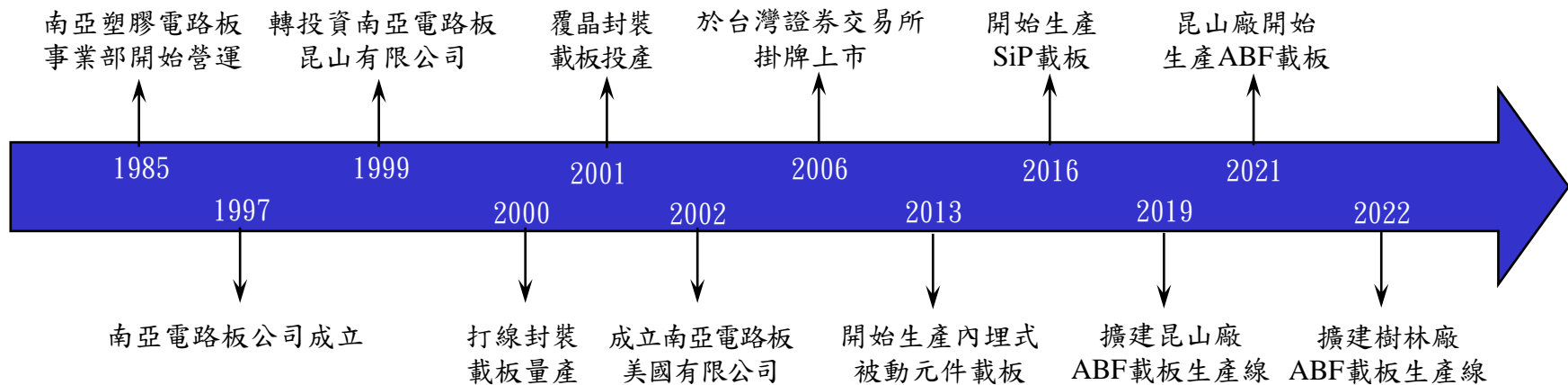
事業簡述

- 南亞塑膠工業股份有限公司之轉投資公司
- 生產與銷售IC載板與一般電路板
- 2022年前三季合併營業額為新台幣 469.4億元。
- 台股上市市值：新台幣1,221.2億元(2022年9月30日)
- 生產廠區：台灣、大陸



公司概況

歷史沿革



- 1985 : 南亞塑膠公司電路板事業部成立並開始生產一般電路板
- 1997 : 經南亞塑膠董事會通過，以轉投資方式成立南亞電路板公司
- 1999 : 轉投資南亞電路板(昆山)有限公司，註冊資本額2,980萬美元
- 2000 : 進入IC載板領域並量產打線封裝載板
- 2001 : 進行技術升級，開始投產覆晶封裝載板
- 2002 : 成立南亞電路板(美國)有限公司
- 2006 : 正式於台灣證券交易所掛牌上市，交易代號為8046
- 2013 : 產品技術升級，開始生產內埋式被動元件載板
- 2016 : 開始生產系統級封裝載板(System in Package, SiP)
- 2019 : 因應市場需求，開始於昆山廠擴建ABF載板生產線
- 2021 : 昆山廠開始生產ABF載板
- 2022 : 樹林廠開始生產ABF載板



財務狀況

近三年前三季合併營業收入(IFRS)

新台幣百萬元

營業額

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0

■ 年成長率

+25.3%

+36.1%

27,526.6

37,454.5

46,942.8

2020年前三季

2021年前三季

2022年前三季

- 2021年前三季營收較2020年前三季增加36.1%:
本公司因遠距商務、居家娛樂等應用產品需求提升，營運績效持續改善，2021年前三季營收比2020年同期再成長。
- 2022年前三季營收較2021年前三季增加25.3%:
本公司因量產5奈米電腦處理器與系統級封裝應用載板，高值化產品銷售增加，2022年前三季營收比2021年同期大幅成長。



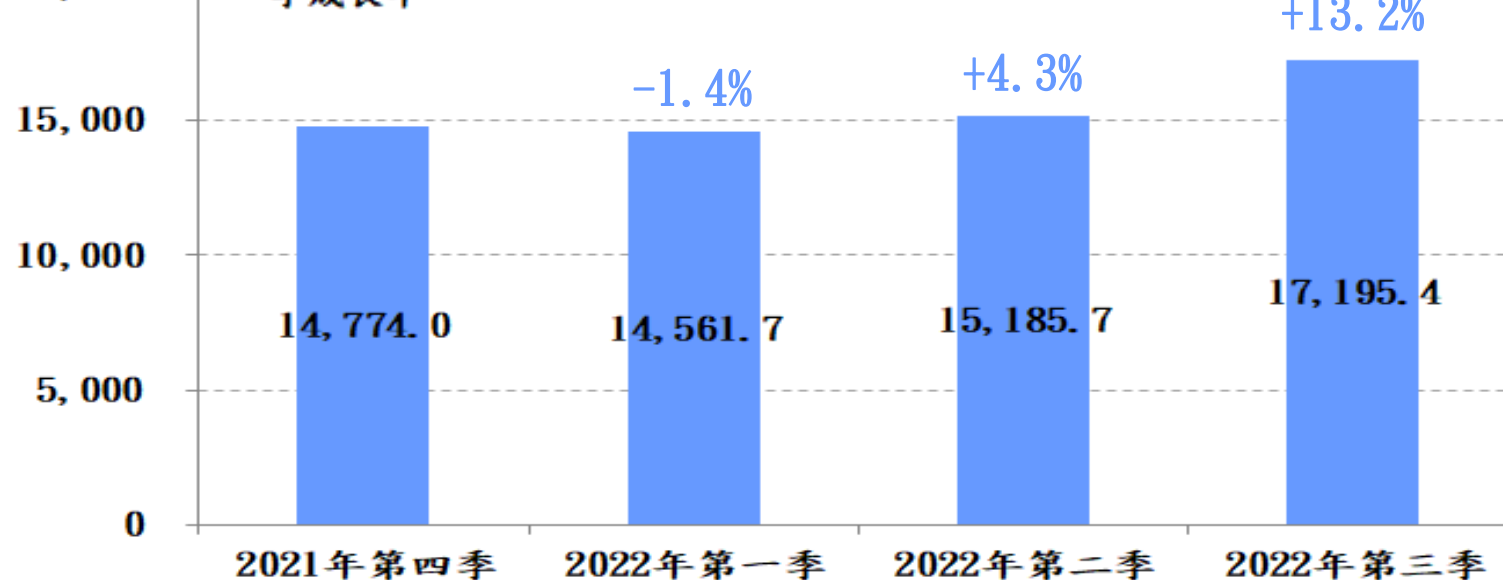
財務狀況

近一年每季合併營業收入(IFRS)

新台幣百萬元

營業額

20,000

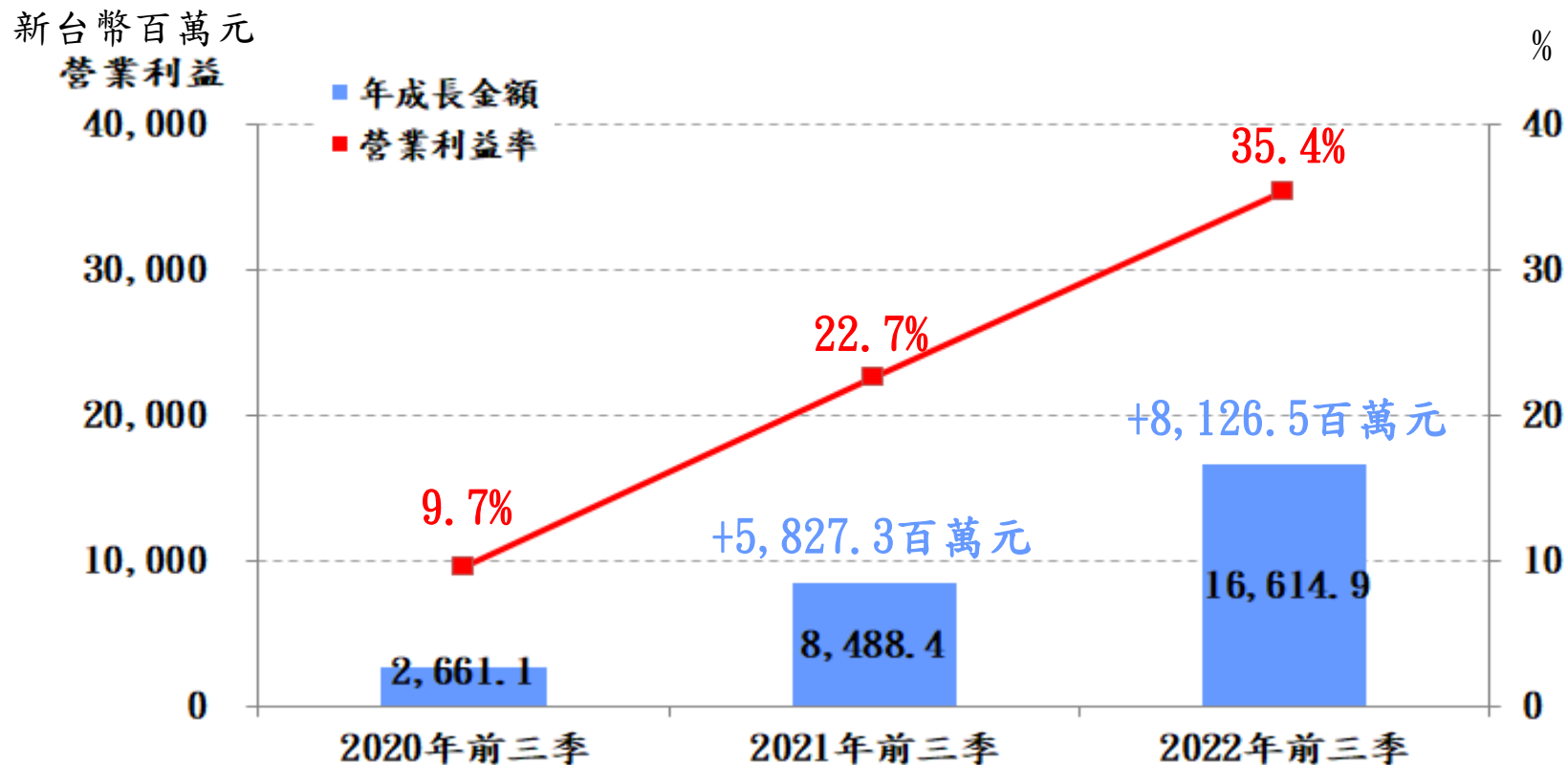


- 2022年第一季營收較2021年第四季減少1.4%:
第一季因工作天數減少，營收比第四季略為下滑。
- 2022年第二季營收較2022年第一季增加4.3%:
第二季因高值化產品銷售持續成長，抵銷4月昆山廠靜態管理與5月台灣疫情影響，營收比第一季成長。
- 2022年第三季營收較2022年第二季增加13.2%:
第三季受益於5奈米電腦處理器應用載板等高值化產品量產，營收比第二季顯著提高。



財務狀況

近三年前三季營業利益

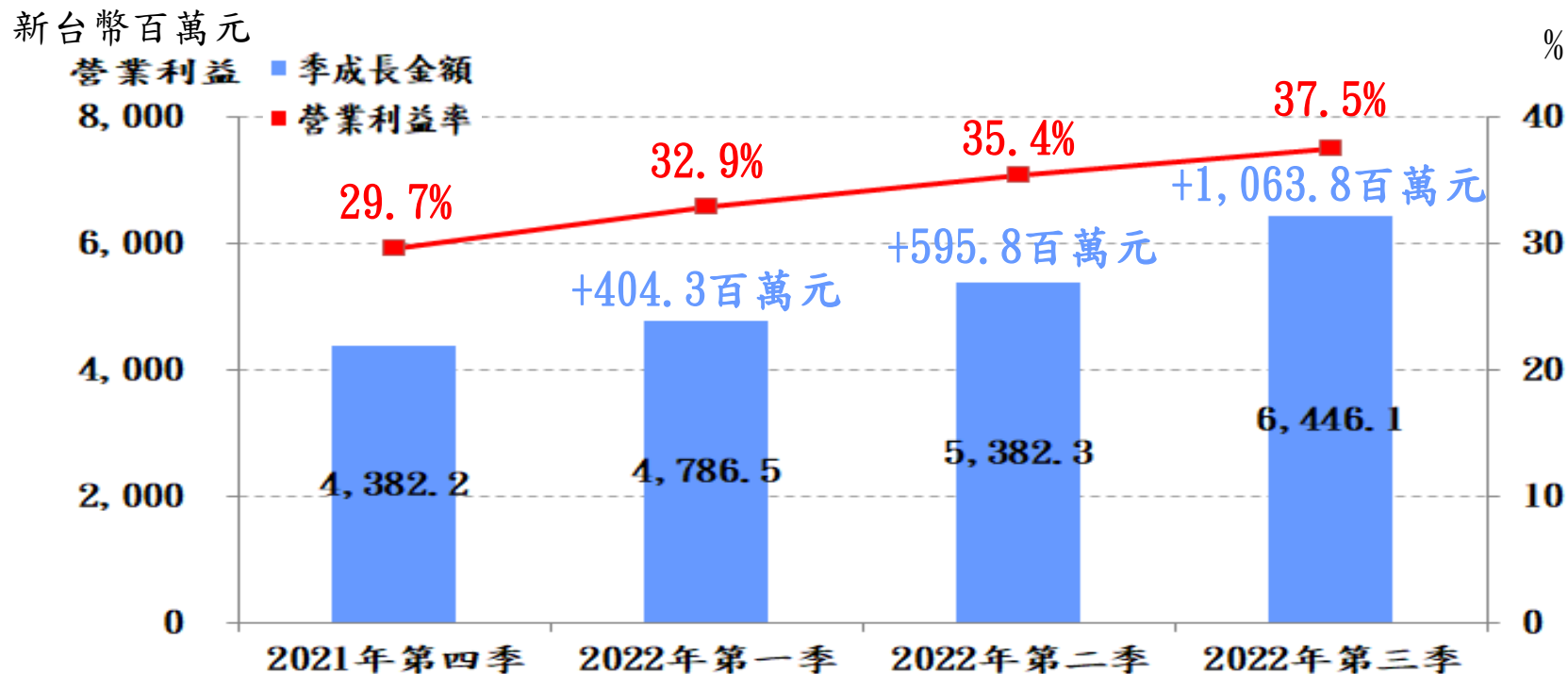


- 2021年前三季營業利益較2020年前三季增加5,827.3百萬元：
除高值化產品銷售增加與IC載板新產能貢獻外，亦持續將人工智慧導入生產管理，優化製程，前三季營業利益持續提升。
- 2022年前三季營業利益較2021年前三季增加8,126.5百萬元：
本公司針對高階IC載板製程去瓶頸，並提高生產效率，增加產出，且高值化產品銷售提高，前三季營業利益比去年同期成長。



財務狀況

近一年每季營業利益

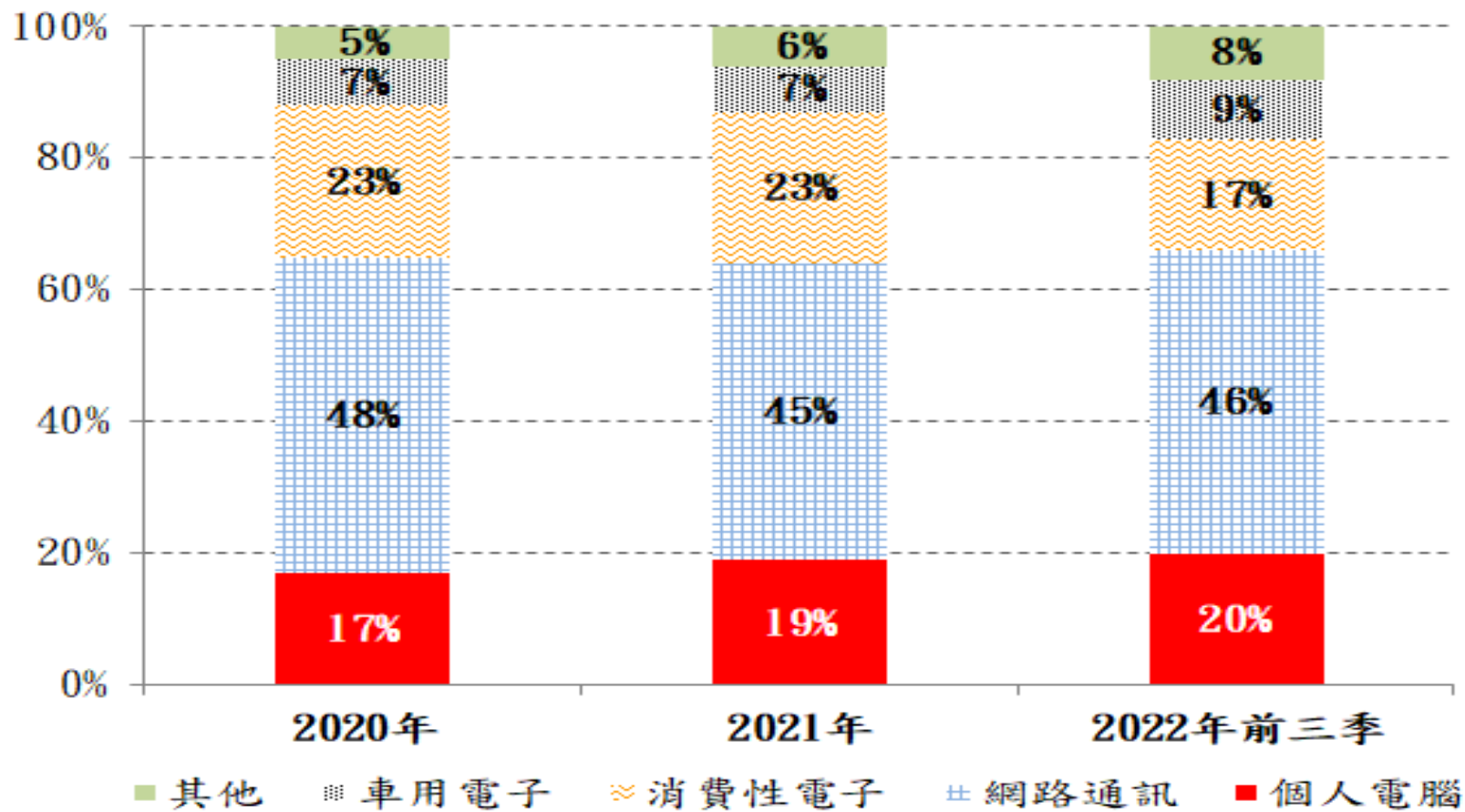


- 2022年第一季營業利益較2021年第四季增加404.3百萬元：
高階IC載板銷售持續成長，進一步提升本公司獲利。
- 2022年第二季營業利益較2022年第一季增加595.8百萬元：
本公司除大尺寸高層數高階IC載板銷售增加外，並導入數位管理、人工智慧改善生產良率與效率，使獲利持續成長。
- 2022年第三季營業利益較2022年第二季增加1,063.8百萬元：
下半年起開始量產5奈米電腦處理器，第三季獲利比第二季再成長。



財務狀況

營業收入結構(應用別)

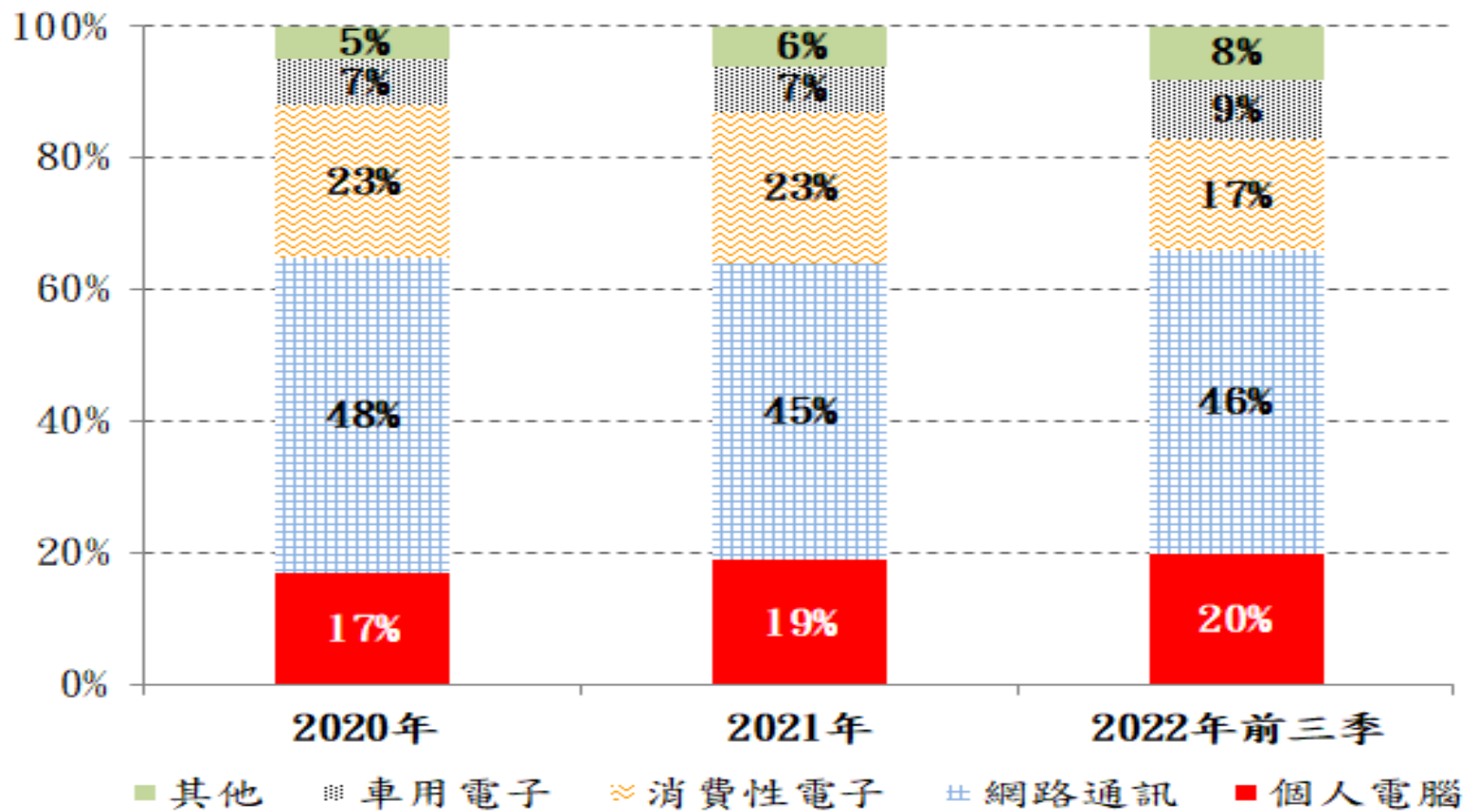


- 本公司因客戶推出5奈米電腦處理器，市占率提升，且高階網通設備需求回溫，2022年前三季個人電腦與網通營收比重提高。
- 受通貨膨脹與消費型態改變影響，消費性電子產品訂單減少，2022年前三季相關營收比重下滑。



財務狀況

營業收入結構(應用別)



- 因電動車銷售增加，且汽車採用更多電子設備，帶動車用電路板需求成長，2022年前三季車用電子營收比重增加。
- 本公司積極爭取更多資料中心與邊緣運算商機，大尺寸高層數IC載板銷售增加，2022年前三季相關營收比重再成長。



產品未來發展方向

持續拓展高值化產品

■ ABF載板

2023年將與客戶緊密合作，持續開發5奈米電腦處理器、資料中心伺服器、交換器及5G基地台應用載板；台灣廠將持續優化先進製程，生產高層數、大尺寸及細線路產品；昆山廠也將生產高階產品，以滿足當地客戶需求。

■ BT載板

針對IC異質晶片封裝發展趨勢，本公司將開發新世代行動裝置系統級封裝載板，並積極因應資料中心與車用電子市場迅速成長，未來將量產5G光通訊收發模組、網路交換器、車用網路及車用多媒體影音系統應用產品。

■ 一般電路板

伴隨行動裝置、消費性及車用電子等產品設計愈趨精密，中介板、HDI等產品需求提高，本公司2023年將量產新世代5G手機中介板、伺服器應用固態硬碟、LED燈珠、工業用無人車及汽車ADAS應用產品，以優化產品組合。



未來營運目標

公司營運績效持續成長

- 培養優秀的研發與製程技術人才，強化研究開發量能，以開發新材料與新技術，提升生產能力與良率，並增加產品附加價值。
- 參與客戶設計，共同開發及提供原生數據，分享生產資訊，縮短交期。
- 持續針對2.5D/3D先進封裝趨勢發展，開發更多高階IC載板，以提升高值化產品銷售比重。
- 持續將人工智慧導入營運管理模式，推動智能化生產，並優化製程條件與設備效能，以軟硬並進的策略，提升良率與效率。
- 因應美中半導體不同陣營發展，依計畫擴建兩岸高階IC載板產能，增加高值化產品產量，使公司維持高度競爭力。
- 持續推動ESG專案，訂定國際科學基礎減碳目標，落實企業社會責任。
 - 2021年完成減碳4,251噸CO₂e/年，及每日節電12,458度。
 - 持續推動減碳專案，並於2023年建置太陽能發電系統，預計每年減碳334噸CO₂e/年。
 - 致力於達成2020年~2030年溫室氣體排放量減碳25%。



感謝您的聆聽

